

# 2018年中国半导体封装与测试市场分析报告- 行业深度调研与投资前景预测

报告大纲

观研报告网

[www.chinabaogao.com](http://www.chinabaogao.com)

## 一、报告简介

观研报告网发布的《2018年中国半导体封装与测试市场分析报告-行业深度调研与投资前景预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/354758354758.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、报告目录及图表目录

半导体的生产模式可分为以下两类：第一类是垂直一体化模式（IDM，Integrated Device Manufacturing），采用该模式厂商从事涵盖从半导体芯片设计、生产制造到封装与测试的全产业链业务，代表厂商有英特尔、三星等；第二类是无晶圆模式（Fabless）或代工模式（Foundry），通常也被称之为芯片设计公司，采用该模式的厂商仅进行芯片的设计、研发、应用和销售，而芯片的制造、封装与测试，则由特定的厂商负责完成，专业从事芯片生产制造的晶圆厂商，如台积电；专业从事芯片封装测试的厂商，如日月光和矽品。

封装与测试行业的上游产业是：芯片设计公司或芯片制造公司，芯片设计公司设计出符合消费者需求的线路设计和转换版图，芯片制造公司根据设计图纸完成芯片制造，封装与测试公司则完成芯片的封装与测试，最终形成了具备特定功能的半导体元器件产品，实现了芯片功能从图纸到成品的转变。

随着先进封装技术的不断发展，芯片设计公司已经开始与封装测试公司合作对半导体元器件的各项性能做最优的协同设计，半导体封装技术环节已然成为最终器件在设计之初的重要考量因素。

封装与测试行业的下游产业是：在垂直一体化模式下，封装与测试行业的最终下游为电子产品制造公司，其对封装与测试好的半导体元器件进行组装、焊接、调试、检验，最后形成具有特定功能的电子产品。在代工模式下，芯片设计公司提供芯片，半导体封装与测试企业对芯片进行加工，此时，芯片设计公司便成为了半导体封装与测试的下游。

当前半导体应用领域跨越消费，通信，医疗，汽车和航天等，伴随物联网、智能化、新能源、信息安全等趋势的发展，半导体市场将会不断增大，下游产业也将越来越大。

半导体封装和测试行业产业链 资料来源：观研天下数据中心整理

我国是全球最大、增长最快的半导体市场。我国的集成电路产业发展很快，半导体分立器件产业也在快速发展。

半导体主要包括集成电路和分立器件两大组成部分，从功能上来说，集成电路功能较为复杂，分立器件功能较为单一。半导体分立器件的形成是由于受到工艺类型，使用环境（如高温、高压、高湿等），以及功能（交、直流转换等）等因素的综合限制，核心器件难以进入主控芯片，而以独立体系不集成的电路协同工作。

半导体分立器件通常沿着功率和频率两个方向发展新的理论和结构。目前的方向主要有：发展电子信息产品急需的高端分立器件，发展以SiGe、SiC、InP、GaN等化合物半导体材料为基础的新型器件，发展纳米器件、超导器；发展适应于不同功率型元器件的封装技术。

观研天下发布的《2018年中国半导体封装与测试市场分析报告-行业深度调研与投资前景预测》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

## 第一章 2016-2018年中国半导体封装与测试行业发展概述

### 第一节 半导体封装与测试行业发展情况概述

- 一、半导体封装与测试行业相关定义
- 二、半导体封装与测试行业基本情况介绍
- 三、半导体封装与测试行业发展特点分析

### 第二节 中国半导体封装与测试行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、半导体封装与测试行业产业链条分析
- 三、中国半导体封装与测试行业产业链环节分析

## 1、上游产业

## 2、下游产业

### 第三节 中国半导体封装与测试行业生命周期分析

#### 一、半导体封装与测试行业生命周期理论概述

#### 二、半导体封装与测试行业所属的生命周期分析

### 第四节 半导体封装与测试行业经济指标分析

#### 一、半导体封装与测试行业的赢利性分析

#### 二、半导体封装与测试行业的经济周期分析

#### 三、半导体封装与测试行业附加值的提升空间分析

### 第五节 中国半导体封装与测试行业进入壁垒分析

#### 一、半导体封装与测试行业资金壁垒分析

#### 二、半导体封装与测试行业技术壁垒分析

#### 三、半导体封装与测试行业人才壁垒分析

#### 四、半导体封装与测试行业品牌壁垒分析

#### 五、半导体封装与测试行业其他壁垒分析

## 第二章 2016-2018年全球半导体封装与测试行业市场发展现状分析

### 第一节 全球半导体封装与测试行业发展历程回顾

### 第二节 全球半导体封装与测试行业市场区域分布情况

### 第三节 亚洲半导体封装与测试行业地区市场分析

#### 一、亚洲半导体封装与测试行业市场现状分析

#### 二、亚洲半导体封装与测试行业市场规模与市场需求分析

#### 三、亚洲半导体封装与测试行业市场前景分析

### 第四节 北美半导体封装与测试行业地区市场分析

#### 一、北美半导体封装与测试行业市场现状分析

#### 二、北美半导体封装与测试行业市场规模与市场需求分析

#### 三、北美半导体封装与测试行业市场前景分析

### 第五节 欧盟半导体封装与测试行业地区市场分析

#### 一、欧盟半导体封装与测试行业市场现状分析

#### 二、欧盟半导体封装与测试行业市场规模与市场需求分析

#### 三、欧盟半导体封装与测试行业市场前景分析

### 第六节 2018-2024年世界半导体封装与测试行业分布走势预测

### 第七节 2018-2024年全球半导体封装与测试行业市场规模预测

## 第三章 中国半导体封装与测试产业发展环境分析

## 第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析
- 四、全社会消费品半导体封装与测试总额
- 五、城乡居民收入增长分析
- 六、居民消费价格变化分析
- 七、对外贸易发展形势分析

## 第二节 中国半导体封装与测试行业政策环境分析

- 一、行业监管体制现状
- 二、行业主要政策法规

## 第三节 中国半导体封装与测试产业社会环境发展分析

- 一、人口环境分析
- 二、教育环境分析
- 三、文化环境分析
- 四、生态环境分析
- 五、消费观念分析

## 第四章 中国半导体封装与测试行业运行情况

### 第一节 中国半导体封装与测试行业发展状况情况介绍

- 一、行业发展历程回顾
- 二、行业创新情况分析
- 三、行业发展特点分析

### 第二节 中国半导体封装与测试行业市场规模分析

### 第三节 中国半导体封装与测试行业供应情况分析

### 第四节 中国半导体封装与测试行业需求情况分析

### 第五节 中国半导体封装与测试行业供需平衡分析

### 第六节 中国半导体封装与测试行业发展趋势分析

## 第五章 中国半导体封装与测试所属行业运行数据监测

### 第一节 中国半导体封装与测试所属行业总体规模分析

- 一、企业数量结构分析
- 二、行业资产规模分析

### 第二节 中国半导体封装与测试所属行业产销与费用分析

- 一、流动资产

## 二、销售收入分析

## 三、负债分析

## 四、利润规模分析

## 五、产值分析

### 第三节 中国半导体封装与测试所属行业财务指标分析

#### 一、行业盈利能力分析

#### 二、行业偿债能力分析

#### 三、行业营运能力分析

#### 四、行业发展能力分析

## 第六章 2016-2018年中国半导体封装与测试市场格局分析

### 第一节 中国半导体封装与测试行业竞争现状分析

#### 一、中国半导体封装与测试行业竞争情况分析

#### 二、中国半导体封装与测试行业主要品牌分析

### 第二节 中国半导体封装与测试行业集中度分析

#### 一、中国半导体封装与测试行业市场集中度分析

#### 二、中国半导体封装与测试行业企业集中度分析

### 第三节 中国半导体封装与测试行业存在的问题

### 第四节 中国半导体封装与测试行业解决问题的策略分析

### 第五节 中国半导体封装与测试行业竞争力分析

#### 一、生产要素

#### 二、需求条件

#### 三、支援与相关产业

#### 四、企业战略、结构与竞争状态

#### 五、政府的作用

## 第七章 2016-2018年中国半导体封装与测试行业需求特点与价格走势分析

### 第一节 中国半导体封装与测试行业消费特点

### 第二节 中国半导体封装与测试行业消费偏好分析

#### 一、需求偏好

#### 二、价格偏好

#### 三、品牌偏好

#### 四、其他偏好

### 第三节 半导体封装与测试行业成本分析

### 第四节 半导体封装与测试行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国半导体封装与测试行业价格现状分析

第六节 中国半导体封装与测试行业平均价格走势预测

一、中国半导体封装与测试行业价格影响因素

二、中国半导体封装与测试行业平均价格走势预测

三、中国半导体封装与测试行业平均价格增速预测

第八章 2016-2018年中国半导体封装与测试行业区域市场现状分析

第一节 中国半导体封装与测试行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地半导体封装与测试市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区半导体封装与测试市场规模分析

四、华东地区半导体封装与测试市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区半导体封装与测试市场规模分析

四、华中地区半导体封装与测试市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区半导体封装与测试市场规模分析

第九章 2016-2018年中国半导体封装与测试行业竞争情况

第一节 中国半导体封装与测试行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国半导体封装与测试行业SWOT分析



一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国半导体封装与测试行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 半导体封装与测试行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

#### 四、公司优劣势分析

##### 第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

#### 四、公司优劣势分析

##### 第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营产品
- 三、运营情况

- 1、主要经济指标情况
- 2、企业盈利能力分析
- 3、企业偿债能力分析
- 4、企业运营能力分析
- 5、企业成长能力分析

#### 四、公司优劣势分析

## 第十一章 2018-2024年中国半导体封装与测试行业发展前景分析与预测

### 第一节 中国半导体封装与测试行业未来发展前景分析

- 一、半导体封装与测试行业国内投资环境分析
- 二、中国半导体封装与测试行业市场机会分析
- 三、中国半导体封装与测试行业投资增速预测

### 第二节 中国半导体封装与测试行业未来发展趋势预测

### 第三节 中国半导体封装与测试行业市场发展预测

- 一、中国半导体封装与测试行业市场规模预测

二、中国半导体封装与测试行业市场规模增速预测

三、中国半导体封装与测试行业产值规模预测

四、中国半导体封装与测试行业产值增速预测

五、中国半导体封装与测试行业供需情况预测

第四节中国半导体封装与测试行业盈利走势预测

一、中国半导体封装与测试行业毛利润同比增速预测

二、中国半导体封装与测试行业利润总额同比增速预测

第十二章 2018-2024年中国半导体封装与测试行业投资风险与营销分析

第一节 半导体封装与测试行业投资风险分析

一、半导体封装与测试行业政策风险分析

二、半导体封装与测试行业技术风险分析

三、半导体封装与测试行业竞争风险分析

四、半导体封装与测试行业其他风险分析

第二节 半导体封装与测试行业企业经营发展分析及建议

一、半导体封装与测试行业经营模式

二、半导体封装与测试行业销售模式

三、半导体封装与测试行业创新方向

第三节 半导体封装与测试行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第十三章 2018-2024年中国半导体封装与测试行业发展策略及投资建议

第一节 中国半导体封装与测试行业品牌战略分析

一、半导体封装与测试企业品牌的重要性

二、半导体封装与测试企业实施品牌战略的意义

三、半导体封装与测试企业品牌的现状分析

四、半导体封装与测试企业的品牌战略

五、半导体封装与测试品牌战略管理的策略

第二节 中国半导体封装与测试行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

## 五、实施重点客户战略要重点解决的问题

### 第三节 中国半导体封装与测试行业战略综合规划分析

- 一、战略综合规划
- 二、技术开发战略
- 三、业务组合战略
- 四、区域战略规划
- 五、产业战略规划
- 六、营销品牌战略
- 七、竞争战略规划

## 第十四章 2018-2024年中国半导体封装与测试行业发展策略及投资建议

### 第一节 中国半导体封装与测试行业产品策略分析

- 一、服务产品开发策略
- 二、市场细分策略
- 三、目标市场的选择

### 第二节 中国半导体封装与测试行业定价策略分析

### 第三节 中国半导体封装与测试行业营销渠道策略

- 一、半导体封装与测试行业渠道选择策略
- 二、半导体封装与测试行业营销策略

### 第四节 中国半导体封装与测试行业价格策略

### 第五节 观研天下行业分析师投资建议

- 一、中国半导体封装与测试行业重点投资区域分析
- 二、中国半导体封装与测试行业重点投资产品分析（FSW）

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/bandaoti/354758354758.html>